

護銅劑 # 177、WPF-207

簡介：

各種各樣的方法被使用為了印製電路板銅箔的保護。然而，其主要的用途在於含有樹酯的有機溶液和錫焊劑互相融合、可以嚴密地被控制。今後，還需要面對環境污染的問題。但是，問題存在於鍍金部分如果水溶會變色。為了使用鍍金方式，混雜裝載板的用途被制約了。雖然水溶類型、耐熱等優點被適當地用於應付金板材的色變，但問題仍未解決。現在我們所使用的這種方法將能有效的控制用於混雜裝載板鍍金的時後，不會產生色變的情況。

特徵：

可以防止鍍（化）金部分的變色。

僅以 60~90 秒鐘的處理時間，即可形成皮膜。

因有一套銅離子去除法，減少因銅離子的混入而導致的換槽次數。

由於所形成的皮膜既薄且均勻，使銅箔具有極佳的平滑性，非常適合用於高密度組裝的基板。

規格：

177：

外觀：微白色液狀

比重：0.976±0.01（20℃）

酸鹼值：8.6±0.1（20℃）

有效成分濃度：100±10%

WPF-207：

外觀：無色透明液狀

比重：1.01±0.01（20℃）

酸鹼值：3.2±0.1（20℃）

酸價：35±5

有效成分濃度：100±10%